

貼片電阻材料成份參數  
Chip Resistor of Ingredients a rate REPORT

P/N	Material		Substance		% of Wt.	% of total Wt.	CAS No.	
ALL ITEM	Substrate	白基板	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	三氧化二鋁	80	82.6	1344-28-1	
			SiO <sub>2</sub>	二氧化矽	2.5		7631-86-9	
			MgO	氧化鎂化合物	0.1		1309-48-4	
	Inner term	端電極	Ag	銀	7	7.4	7440-22-4	
			CuO	氧化銅化合物	0.3		1317-38-0	
			Pd	鈀	0.1		744-05-3	
	Res element	電阻層	RuO	氧化鈦	0.5	1.3	12036-10-1	
			PbO	氧化鉛	0.2		1317-36-8	
			ZnO	氧化鋅	0.1		1314-13-2	
			Pd	鈀	0.2		744-05-3	
			Ba	鋇及鋇化合物	0.1		1309-64-4	
			B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	三氧化二硼	0.1		1303-86-2	
			MnO	氧化錳	0.1		1318-13-9	
	Coating (G1)	保護層 (G1)	Frits (SiO <sub>2</sub> -	玻璃	0.8	1	65997-18-4	
			Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	氧化鉻化合物	0.2		1308-38-9	
	Coating (G2)	保護層 (G2)	EPOXY	樹脂	1.2	1.2	25068-38-6	
	Center term	電鍍層Ni	Ni	鎳及化合物	2.5	2.5	7440-02-0	
	Outer term	電鍍層Sn	Sn	錫	4	4	7440-31-5	
	Total %					100%		QA050613

